



March 16, 2018

TAIEX : 8070

CWE Commit to Total Excellence

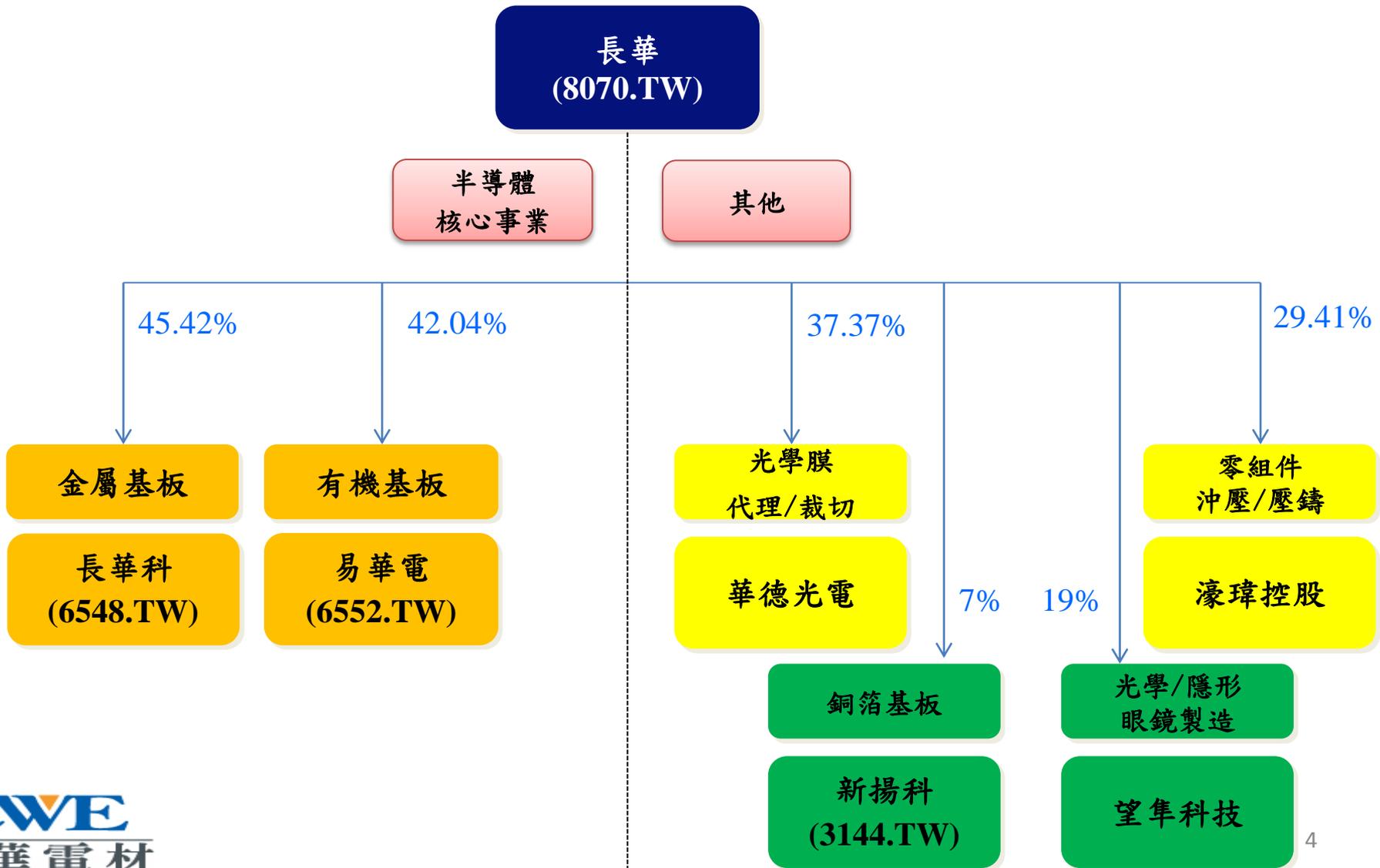
大綱

- 公司簡介
- 營運績效
- 未來展望

公司簡介

設立日期	1989年5月13日
董事長	黃嘉能
實收資本額	新台幣6.39億元
員工人數	91人(單一) 1,821人(合併)
主要產品	IC封裝材料與設備
主要轉投資	長華科(6548) 45.42% 易華電(6552) 42.04%
總公司	高雄市楠梓加工出口區

轉投資架構



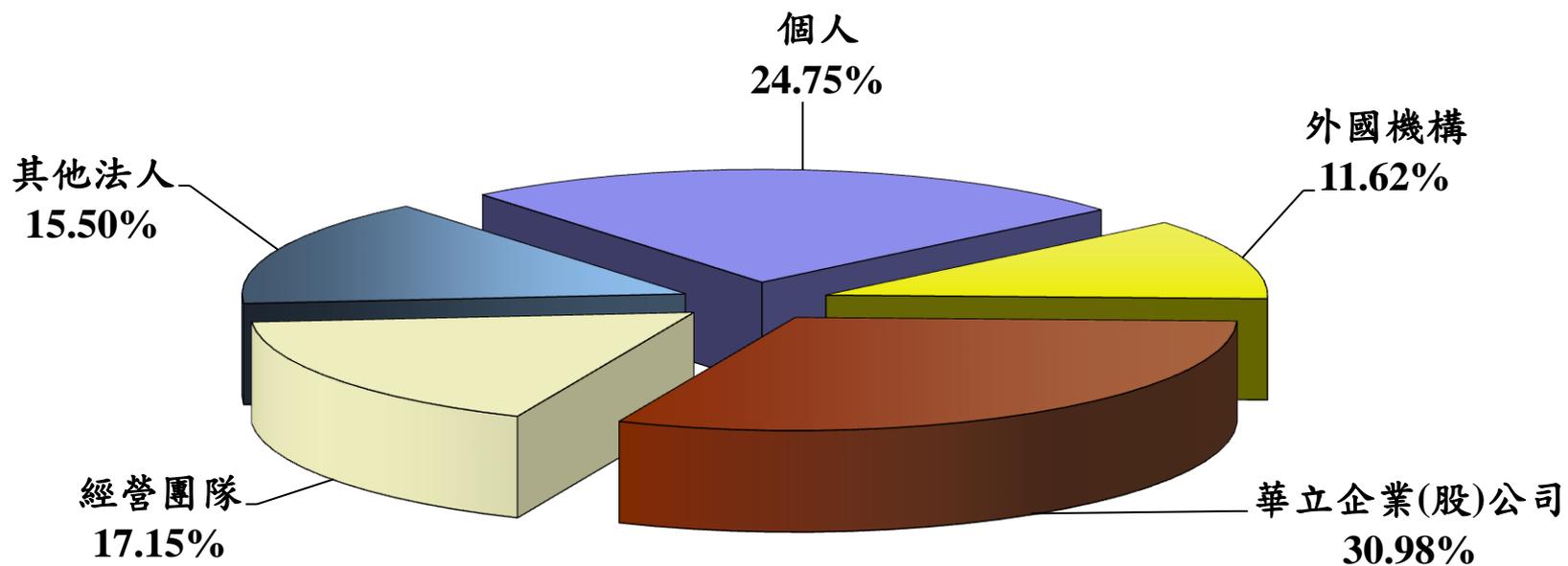
產品之市場地位

產業別	主要商品	國內市佔率
IC封裝材料	封膠樹脂 (EME)	64%
	導電膠(銀膠)及非導電膠 (CRM)	37%
	導線架 (Lead Frame)	30%
	自動模壓設備 (Auto Molding Equipment)	35%
	去渣成型設備 (Trim & Form Equipment)	80%

轉投資公司持股價值

轉投資公司/新台幣仟元	長華科(6548)	易華電(6552)	濠瑋	華德
持股比重	45.42%	42.04%	29.41%	37.37%
持有股數	16,400,397	42,042,867	20,000,000	24,142,706
帳上金額	2,208,134	1,347,077	788,076	343,609
近期每股市價(元)	400.00	60.00	-	-
估算市值	6,560,159	2,522,572	-	-

股東結構(2017/5)



營運績效(合併季損益表)

單位：NTD百萬元	2017年第四季		2016年第四季		變動率	2017年第三季		變動率
	金額	%	金額	%	%	金額	%	%
營業收入	3,911	100.0	2,668	100.0	46.6	3,830	100.0	2.1
銷貨成本	3,343	85.5	2,464	92.3	35.7	3,217	84.0	3.9
營業毛利	568	14.5	205	7.7	177.6	612	16.0	(7.3)
營業費用	286	7.3	125	4.7	128.4	234	6.1	22.1
營業淨利	282	7.2	80	3.0	254.8	379	9.9	(25.4)
營業外損益	2	0.1	95	3.6	(97.6)	45	1.2	(94.9)
稅前淨利	285	7.3	174	6.5	63.1	423	11.0	(32.7)
所得稅費用	68	1.7	44	1.7	53.1	112	2.9	(39.7)
本期淨利	217	5.5	130	4.9	66.6	311	8.1	(30.2)
淨利歸屬於本公司業主	119		122		(2.0)	219		(45.5)
淨利歸屬於非控制權益	97		8		1,084.7	92		6.2
每股盈餘(元)-稅後	1.87		1.86			3.43		

營運績效(合併年損益表)

	2017年		2016年		變動率
	金額	%	金額	%	%
單位：NTD百萬元					
營業收入	14,131	100.0	10,942	100.0	29.1
銷貨成本	12,144	85.9	9,978	91.2	21.7
營業毛利	1,986	14.1	963	8.8	106.2
營業費用	892	6.3	600	5.5	48.7
營業淨利	1,094	7.7	364	3.3	200.9
營業外損益	382	2.7	651	5.9	(41.3)
稅前淨利	1,476	10.4	1,014	9.3	45.5
所得稅費用	363	2.6	175	1.6	107.9
本期淨利	1,113	7.9	840	21.9	32.6
淨利歸屬於本公司業主	872		786		10.9
淨利歸屬於非控制權益	242		54		347.5
每股盈餘(元)-稅後	13.64		11.37		

2013~2017年合併資產負債表

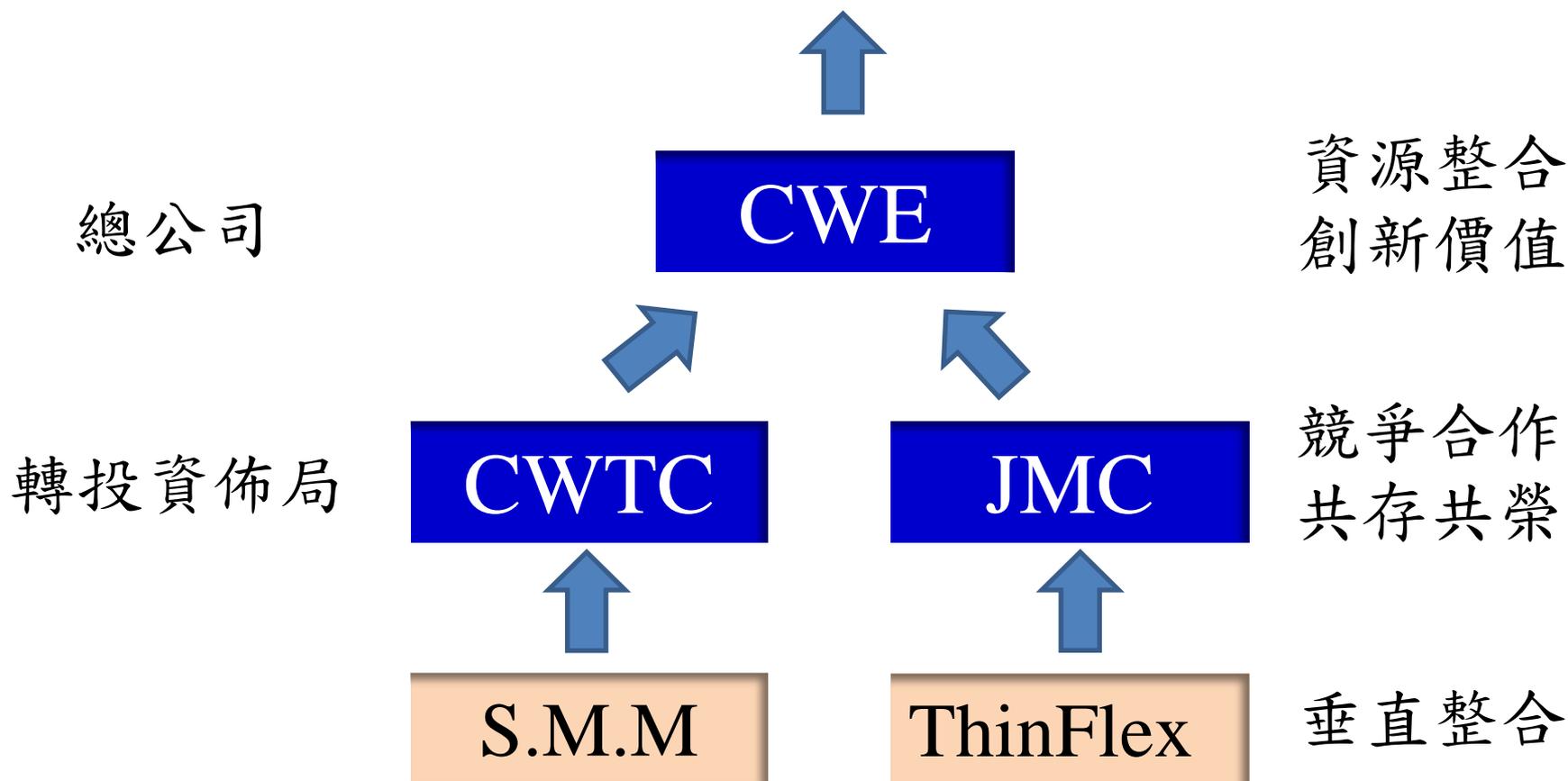
單位：NTD百萬元	2013.12.31 (IFRSs)	2014.12.31 (IFRSs)	2015.12.31 (IFRSs)	2016.12.31 (IFRSs)	2017.12.31 (IFRSs)
現金及短期投資	1,144	1,241	1,427	1,302	3,551
應收帳款	4,778	4,925	4,294	2,598	3,355
流動資產	7,746	8,441	7,828	5,262	9,009
長期投資	1,116	1,125	2,408	3,178	2,940
流動負債	5,211	5,658	5,038	2,938	4,898
長期負債	1,417	2,184	1,972	400	2,287
權益總計	5,632	6,257	6,721	5,867	8,573
總資產	12,482	14,340	13,966	9,438	15,971
每股淨值(元)	56.15	59.30	67.31	81.83	89.93
流動比率	149%	149%	155%	179%	184%
負債比率	55%	56%	52%	38%	46%

歷年獲利及股利

新台幣：元	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
稅後EPS	14.00	0.29	9.34	5.89	5.29	13.57	11.37	13.64
股票股利	0.30	0.29	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
現金股利	9.70	0.60	3.00	3.10	3.50	7.00	10.00	
合計股利	10.00	0.89	3.30	3.10	3.50	7.00	10.00	
股利發放率	71%	307%	35%	53%	66%	52%	88%	

未來展望

晉升為全球IC基板主要供應商之一



成長動能

- 通路業務：持續增加封裝材料產品線，並跨足電動車關鍵材料業務。
- 新型態封裝基板開發：除了開發封裝基板原材料通路業務外，並持續進行薄型化封裝基板的認證與量產。